

Serie QFS

(0.635 mm) .025"

# Robuste Buchsenleisten Mit Masseebene

## Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe [www.samtec.com?QFS](http://www.samtec.com?QFS)

### Kontaktträger:

Liquid Crystal Polymer  
Phosphor Bronze

### Material (Anschlüsse und Masseebene):

Au über 50 µm (1.27 µm) Ni (Anschluss Masseebene: Zinn)

### Strombelastbarkeit:

Kontakt: 2.6 A pro Kontakt (2 Kontakte belegt)  
Masseebene: 15.7 A pro Masseebene (1 Masseebene belegt)

### Nennspannung:

300 VAC mit QMS

### Betriebstemperatur:

-55 °C bis +125 °C

### RoHS Konform:

Ja

## Passende Steckverbinder:

QMS

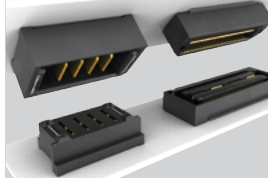
## Passende Kabelkonfektionen:

6QCD

## Abstandshalter:

SO, JSOM

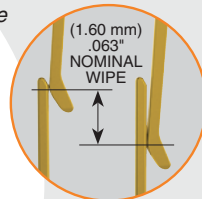
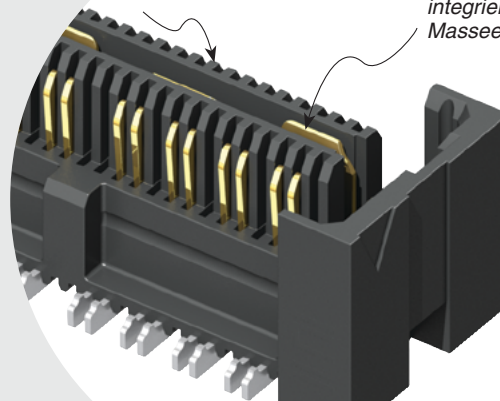
## POWER/SIGNAL APPLICATION



Kompatibel mit den Serien UMPT/UMPS für eine flexible zweiteilige Power/Signal Lösung

Entworfen für Rugged Applikationen

integrierte Masseebene



**ebenfalls erhältlich**  
(Mindestbestellmenge erforderlich)

- Weitere Beschichtungen
  - Ohne Zentrierstift-Option
  - Hot Pluggable
  - 4 Gruppen (104) -SE, 64 -DP
- Kontaktieren Sie Samtec.

## HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

QMS-DP/QFS-DP @ 10 mm Stapelhöhe  
Bewertung basiert auf dem Samtec Referenzkanal.  
Für die vollständigen SI-Performance Daten kontaktieren Sie bitte [SIG@samtec.com](mailto:SIG@samtec.com) oder besuchen uns unter [www.samtec.com](http://www.samtec.com)

**25**  
Gbps

## Verarbeitung:

### Bleifrei Lötbar:

Ja  
SMD-Koplanarität: (0.10 mm) .004" max. (026-078)  
Platinenstapelung: Für Anwendungen, die mehr als zwei Steckverbinder pro Platine kontaktieren Sie bitte [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com)

## Zertifikate:

Alle Zertifikate finden Sie unter [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



FILE NO. E111594

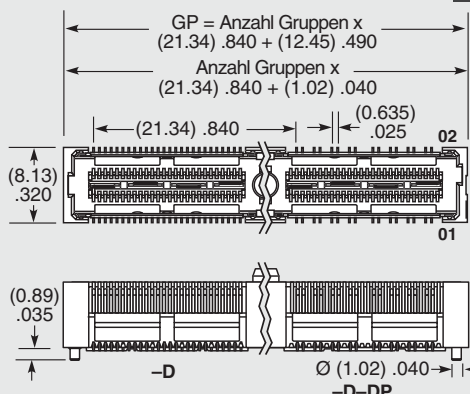
## Industrie Standards:

- SUMIT™
- PCI/104-Express™

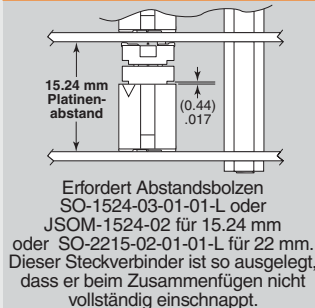
## Anwendungshinweise:

- 100 GbE
- Fibre Channel
- XAUI
- PCI Express®
- SATA

<b>QFS</b>	<b>Kontakte pro Reihe</b> Anzahl Signalpaare	<b>Leiterform</b>	<b>Kontaktmaterial</b>	<b>Typ</b>	<b>A</b>	<b>Optionen</b>
	- 026, - 052, - 078 (52 Signalkontakte pro Gruppe = -D) - 016, - 032, - 048 (16 Signalpaare pro Gruppe = -D-DP)	Auswahl der Leiterform nach der Tabelle	- L (Nur Leiterform -04.25) = 10 µm (0.25 µm) Gold auf Signalkontakten und Masseebene (Signalkontakt-Anschlüsse und Masseanschlüsse verzinkt) - SL (Nur Leiterform -06.25) = 10 µm (0.25 µm) Gold auf Signalkontakten und Masseebene (Signalkontakt-Anschlüsse und Masseanschlüsse verzinkt)	- D = Single-Ended - D-DP Differential Pair (Nur -04.25)		- GP = Führungsbohrungen (nur -04.25)



## Anwendungsbeispiel



Leiterform	A	Stapelhöhe*		
		QMS Leiterform	-05.75	-06.75
-04.25	(7.44) .293	10 mm	11 mm	14 mm
-06.25	(9.42) .371	12 mm	13 mm	16 mm

\*Verarbeitungsprozess kann Höhe im gesteckten Zustand beeinflussen. Siehe SO Serie für Abstandstoleranzen der Leiterplatten.

Industrie-Standard	Verbinder			
	Stifte	Buchse	Gruppen	Platinenabstand
SUMIT™	ASP-129637-01	ASP-129646-01	1	15.24 mm
PCI/104-Express™	ASP-129637-03	ASP-129646-03	3	15.24 mm
PCI/104-Express™	ASP-129637-13	ASP-129646-22	1	15.24 mm
PCI/104-Express™	ASP-142781-01	ASP-129646-01	1	22 mm
PCI/104-Express™	ASP-142781-02	ASP-129646-02	2	22 mm
PCI/104-Express™	ASP-142781-03	ASP-129646-03	3	22 mm